

电子行业周报 (8.19-8.25)

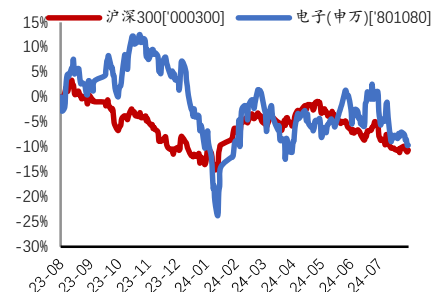
关注《黑神话：悟空》对AI PC及高清显示行业的带动

强于大市(维持评级)

投资要点:

- 《黑神话：悟空》热度爆表，推动PC/高清显示硬件升级。首款国产大型3A游戏《黑神话：悟空》于8月20日正式上线，该游戏凭借其惊艳的画面和深度的故事线吸引了全球玩家的关注，不仅打破国产游戏的销售记录，而且在全球范围内持续霸榜Steam热销商品第一，在全球游戏市场引起风潮。作为承载该现象级游戏的电子硬件，PC、高清显示等领域将势必迎来升级和消费热潮。
- 《黑神话：悟空》与PC共振，助力AI PC加速渗透。想流畅运行这款高品质的游戏，往往需要一款配置强劲、散热出色、屏幕和音效表现优秀的高性能电脑设备。为了获得更好的游戏体验，众多玩家纷纷升级或更换自己的电脑设备，从而带动了PC市场的增长。其中，AI PC因配备了高性能的处理器和神经处理单元，拥有强大的运算能力和数据处理速度，故而可以更好地应对大型游戏运行，让用户得到更流畅的操作体验。因此，《黑神话：悟空》的有望加速AI PC在PC市场中的渗透。据Canalys预测，2024年全球AI PC出货量将达到4800万台，占PC总出货量的18%。预计到2025年，AI PC出货量将超过1亿台，占PC总出货量的40%。
- 《黑神话：悟空》助力显示器焕新，Mini LED有望脱颖而出。黑神话广受欢迎的背后隐藏了消费者对视觉沉浸感的持续追求。该游戏采用了先进的渲染技术，在画质和运行流畅度上都达到了新的高度，随之玩家们对显示效果的要求愈发提高，传统电竞显示器已经难以满足追求极致视觉体验的玩家需求。而Mini LED因其在亮度、对比度以及色彩表现方面表现卓越而备受青睐。其中，Mini LED显示器能够实现更加精准的局部调光，从而带来更深的黑色和更高的亮度，这对于游戏中的细节展现尤为重要。据深圳市平板显示行业协会转引LEDinside显示，在电竞显示器方面，BOE京东方、TCL华星等近年来已推出一系列Mini LED电竞显示器，从分辨率、刷新率、色彩还原度、响应速度等多方面持续创新。黑神话的爆火有望助力显示器的焕新，而Mini LED作为显示领域的高阶产品，有望顺势脱颖而出。
- 投资建议：**Mini LED方向，建议关注：上游芯片厂商三安光电、华灿光电；中游封装/模组厂商聚飞光电、翰博高新、瑞丰光电、沃格光电；下游显示厂商：利亚德、洲明科技、艾比森、雷曼光电、奥拓电子；全产业链一体化布局的兆驰股份；驱动芯片明微电子；显示面板京东方A、TCL科技；显控系统卡莱特、诺瓦星云等。AI PC方向，建议关注：芯片厂商通富微电、龙芯中科；显示面板厂商TCL科技、京东方、伟时电子、龙腾光电等；结构件/零部件厂商春秋电子、福蓉科技、英力股份、胜宏科技、珠海冠宇等；散热方面飞荣达、思泉新材等；制造领域的华勤技术、闻泰科技等。
- 风险提示：**技术发展及落地不及预期；下游终端出货不及预期；下游需求不及预期；市场竞争加剧风险；地缘政治风险；行业景气不

一年内行业相对大盘走势



电子行业估值 (PE)



团队成员

分析师 杨钟
执业证书编号：S0210522110003
邮箱：yz3979@hfzq.com.cn

联系人 詹小璿
邮箱：zxm30169@hfzq.com.cn

相关报告

- 《关注折叠屏手机形态演进及新机发布》——2024.08.18
- 《AI 硬硬件升级，IC 载板或迎机遇》——2024.08.11
- 《关注晶圆载具国产化替代》——2024.08.04

正文目录

一、	本周市场表现.....	3
1.1	电子板块本周表现.....	3
1.2	SW 电子个股本周表现	3
1.3	电子板块估值分析.....	4
二、	行业动态跟踪.....	6
2.1	半导体板块.....	6
2.2	AI 板块.....	6
2.3	消费电子板块.....	12
2.4	汽车电子板块.....	12
2.5	面板板块.....	15
三、	公司动态跟踪.....	16
四、	风险提示.....	17

图表目录

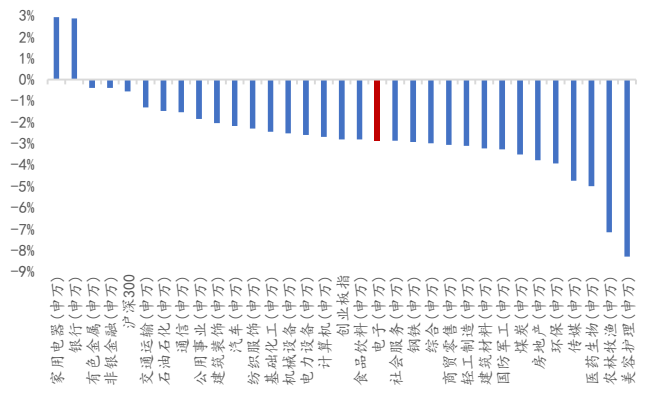
图表 1:	SW 各行业板块本周市场表现.....	3
图表 2:	电子板块成交额及日涨跌幅.....	3
图表 3:	电子细分领域本周涨跌幅 (%)	3
图表 4:	SW 电子本周涨幅前十个股 (%)	4
图表 5:	SW 电子本周跌幅前十个股 (%)	4
图表 6:	SW 电子本周换手率前二十个股 (%)	4
图表 7:	SW 电子行业指数 PE 走势 (TTM)	5
图表 8:	SW 电子细分行业指数 PE 走势 (TTM)	5
图表 9:	过去一周股东增减持更新	16
图表 10:	过去一周股权激励一览.....	17

一、 本周市场表现

1.1 电子板块本周表现

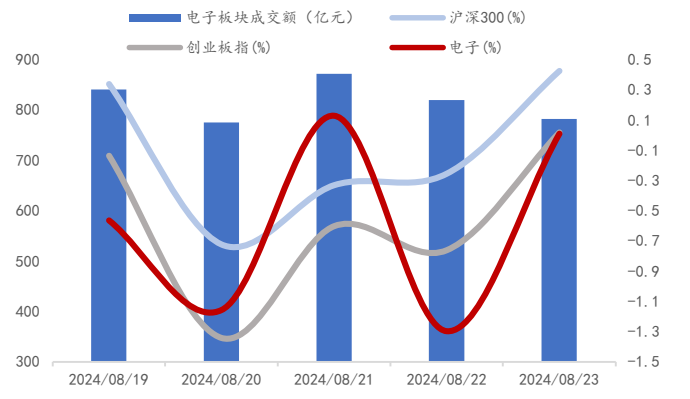
大盘表现上，本周（0819-0825）创业板指数下跌 2.80%，沪深 300 指数下跌 0.55%。本周电子行业指数下跌 2.86%。行业表现上，电子行业涨跌幅位列全行业的第 17 位，本周家用电器、银行、有色金属板块涨跌幅位居前列。

图表 1：SW 各行业板块本周市场表现



数据来源：Wind，华福证券研究所

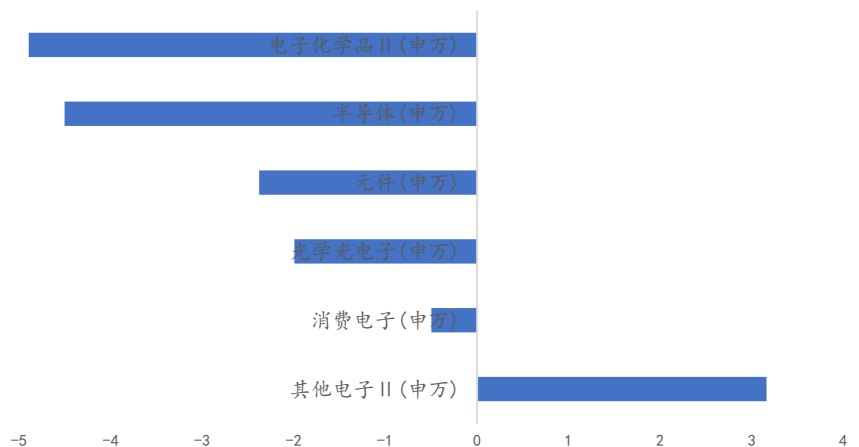
图表 2：电子板块成交额及日涨跌幅



数据来源：Wind，华福证券研究所

从电子细分行业指数看，本周电子细分板块涨跌幅分化，具体来看，其他电子板块领涨，周涨跌幅为+3.16%；电子化学品板块跌幅最大，周涨跌幅为-4.90%。

图表 3：电子细分领域本周涨跌幅 (%)

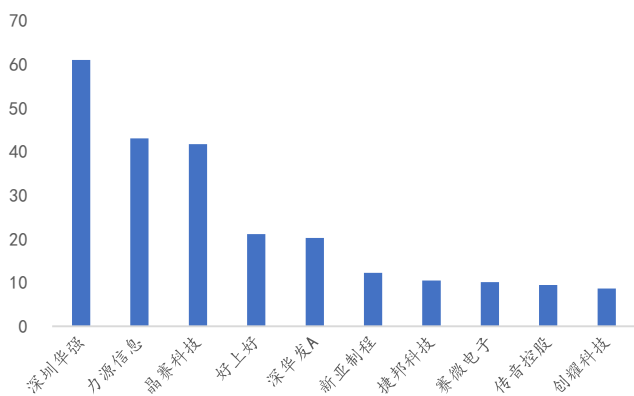


数据来源：Wind，华福证券研究所

1.2 SW 电子个股本周表现

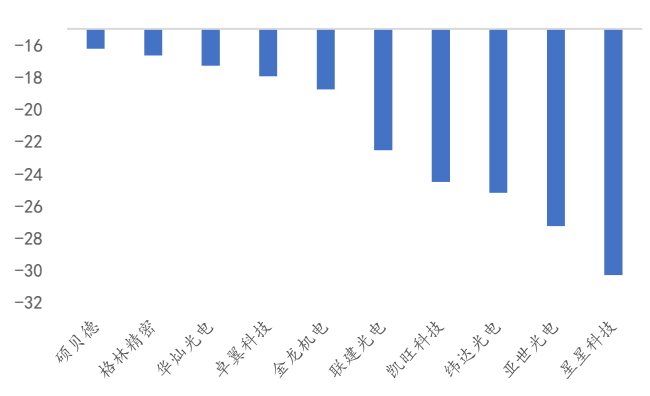
从个股维度来看，SW 电子板块中，深圳华强（61.01%）、力源信息（43.04%）等位列涨幅前列；星星科技（-30.28%）、亚世光电（-27.24%）等位列跌幅前列。

图表 4: SW 电子本周涨幅前十个股 (%)



数据来源: Wind, 华福证券研究所

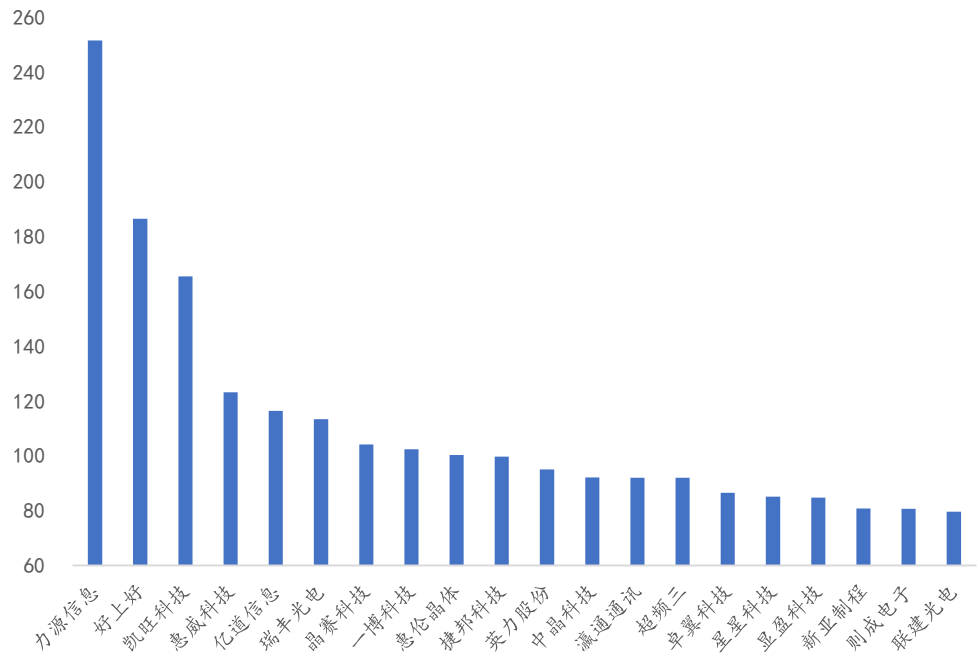
图表 5: SW 电子本周跌幅前十个股 (%)



数据来源: Wind, 华福证券研究所

从换手率来看,本周电子行业个股换手率最高的是力源信息,换手率为251.53%。其余换手率较高的还有好上好(186.40%)、凯旺科技(165.40%)、惠威科技(123.13%)。

图表 6: SW 电子本周换手率前二十个股 (%)

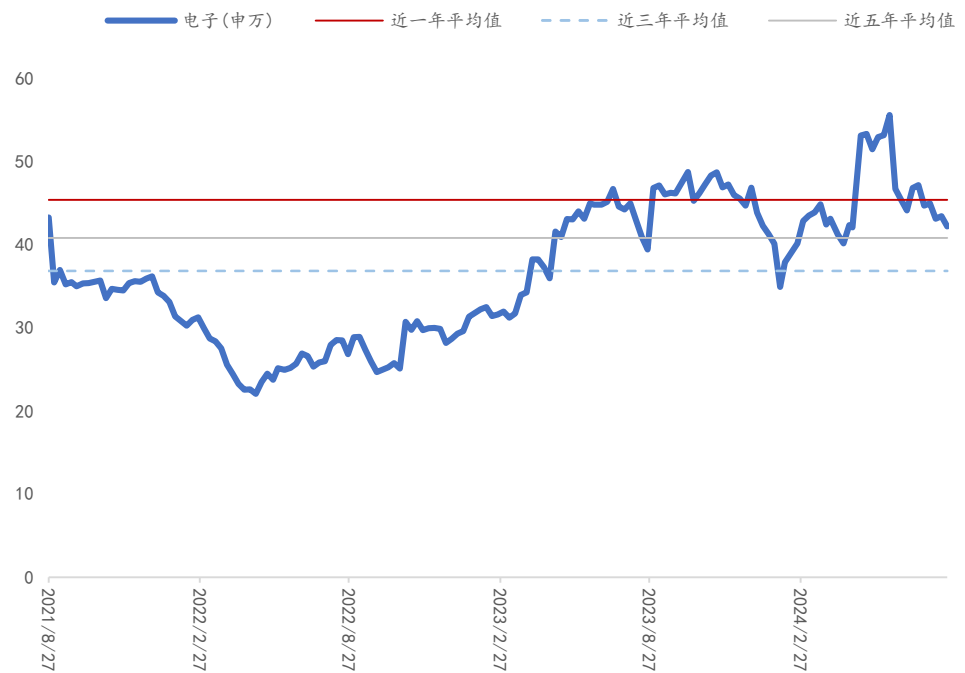


数据来源: Wind, 华福证券研究所

1.3 电子板块估值分析

从本周PE走势来看,整体电子行业估值低于近一年平均值水平,但高于近三年、五年平均值水平。本周PE(TTM)为42.16倍,较上周有所回调。

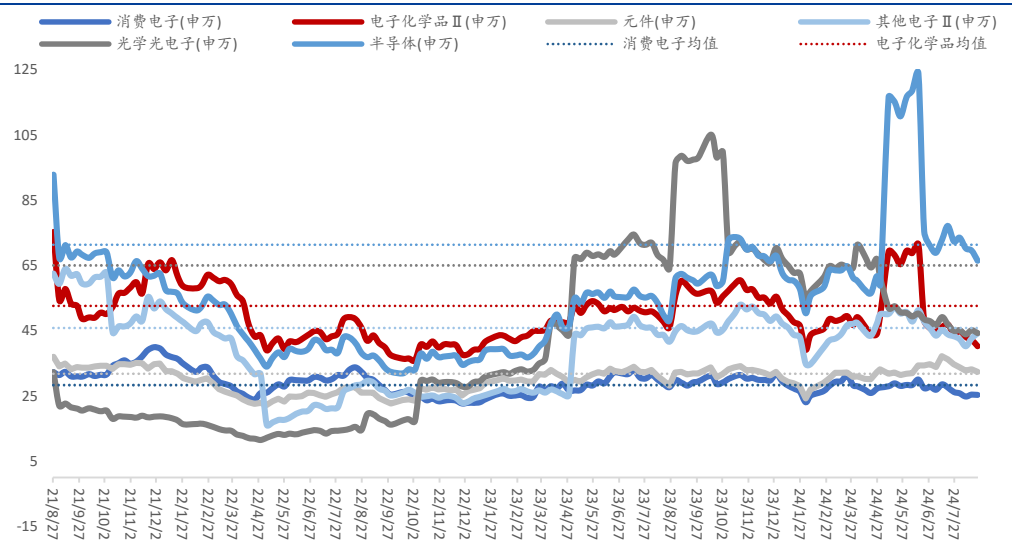
图表 7: SW 电子行业指数 PE 走势 (TTM)



数据来源: Wind, 华福证券研究所

细分领域上, 本周消费电子、电子化学品、元件、其他电子、光学光电子和半导体板块 PE 分别为 25.32、40.25、32.33、44.21、44.29 和 66.44, 本周其他电子板块估值有所上调, 消费电子、电子化学品、元件、光学光电子和半导体板块估值有一定程度回落。

图表 8: SW 电子细分行业指数 PE 走势 (TTM)



数据来源: Wind, 华福证券研究所

二、 行业动态跟踪

2.1 半导体板块

1) 机构：2024 年全球半导体市场将强劲增长，2025 年会有所放缓

多家分析机构预测，2024 年全球半导体市场将强劲发展。据报道，WSTS 的数据显示，2024 年第二季度全球半导体市场规模达到 1499 亿美元，较 2024 年第一季度增长 6.5%，较去年同期增长 18.3%。WSTS 将 2024 年第一季度的预测上调了 30 亿美元，使 2024 年第一季度较去年同期增长 17.8%，而不是之前的 15.3%。

与 2024 年第一季度相比，主要半导体公司 2024 年第二季度的收入增长普遍强劲。在排名前十五的公司中，只有两家公司（联发科和意法半导体）在 2024 年第二季度收入出现下滑。增长最强劲的是内存公司，SK 海力士和铠侠分别上涨超过 30%，三星半导体上涨 23%，美光科技上涨 17%。2024 年第二季度与 2024 年第一季度相比，排名前十五的公司加权平均增长率为 8%，其中内存公司上涨 22%，非内存公司上涨 3%。

根据英伟达 2024 年第一季度的预测，2024 年第二季度其营收为 280 亿美元，英伟达仍是最大的半导体公司。三星以 207 亿美元位居第二。博通尚未公布其 2024 年第二季度业绩，但估计其营收为 130 亿美元，超过英特尔的 128 亿美元。英特尔多年来一直位居第一或第二，但今年下滑至第四位。

2024 年第三季度与 2024 年第二季度相比的收入预期是乐观的，显示出前景广阔。AMD 预计 2024 年第三季度收入将增长 15%，这得益于数据中心和客户端计算的强劲增长。美光表示，内存热潮将继续，供应低于需求，并预计增长 12%。三星半导体和 SK 海力士没有提供收入预期，但两家公司都预计服务器 AI 的需求将继续强劲。

此外，少数公司预计 2024 年第三季度的收入增长率将较低，约为 1%，即英特尔、联发科和意法半导体，其中英特尔将前景疲软归咎于库存过剩。其他五家提供收入指导的公司的收入增长率在 4%至 8%之间。意法半导体和恩智浦半导体预计汽车行业将在 2024 年第三季度有所改善，但工业领域的库存问题仍然存在。德州仪器预计个人电子产品将表现强劲。提供指导的九家非内存公司的 2024 年第三季度加权平均收入增长率为 5%。

2024 年上半年半导体市场的大幅增长（较 2023 年上半年增长 18%）将推动 2024 年全年的强劲增长。过去几个月，业界对 2024 年的预测范围从 Cowan LRA 模型的 14.4%到 Statista Market Insights 的 20.7%。Semiwiki 的半导体情报(SC-IQ)预测 2024 年将增长 17.0%，与 Gartner 的 17.4%和 WSTS 的 16.0%一致。

对 2025 年的四个预测显示出相似的趋势——增长速度虽然放缓但仍保持强劲，从 Semiconductor Intelligence 的 11.0%到 Statista 的 15.6%。2024 年至 2025 年的增长减速范围从 WSTS 的降低 3.5 个百分点（16%至 12.5%）到 Semiwiki 的降低 6

个百分点（17%至 11%）。

Semiwiki 对 2026 年的初步预测为中等个位数。到那时，人工智能和内存市场的复苏势头应该会逐渐减弱。其他主要终端市场（智能手机、个人电脑和汽车）在未来几年可能会保持平稳或低增长。除非出现任何重大的新增长动力来提振市场或经济衰退抑制市场，否则到本世纪末，半导体市场的前景应该会保持在中等个位数。（资料来源：集微网）

2) 机构：Q2 台积电占据全球 62%晶圆代工市场，中芯国际继续稳居第三

近日，据市场研究机构 Counterpoint Research 最新公布的报告称，主要得益于强劲的 AI 需求，2024 年第二季全球晶圆代工业市场营收环比增长约 9%，同比增长约 23%。从厂商排名来看，台积电、三星、中芯国际位列前三。

报告指出，CoWoS 供应仍然吃紧，未来产能扩张可能存在上行空间，重点是 CoWoS-L。尽管非 AI 半导体（例如用于汽车和工业应用的半导体）的需求复苏较慢，但某些应用（例如物联网和消费电子产品）有一些紧急订单。值得注意的是，中国的晶圆代工和半导体市场复苏速度快于全球同行。其中，中芯国际和华虹等中国晶圆代工厂商公布了强劲的季度业绩和积极的指引，因为中国的无晶圆厂客户更早进入库存调整阶段。

在各大代工厂方面，台积电以 62%的市场份额稳居第一，同比增长 4 个百分点。报告指出，受人工智能加速器需求持续强劲增长的推动，台积电 2024 年第二季度的季度营收略有超出预期。因此，台积电进一步将其年度营收预期从之前的 20%中低段上调至 20%中段。此外，台积电预计，到 2025 年底或 2026 年初，人工智能加速器的供需平衡将保持紧张。该公司还计划在 2025 年将其 CoWoS 产能至少再翻一番，以满足客户对人工智能的强劲需求。

此外，三星第二季的市场份额为 13%，同比增长 1 个百分点。报告称，三星代工厂的收入环比增长，主要由于智能手机的库存预建和补货，在 2024 年第二季度以 13%的市场份额保持第二的位置。该公司继续专注于为先进节点争取更多的移动和 AI/HPC 客户，并预计其年收入增长将超过行业增长。

中芯国际第二季度的市场份额为 6%，同比与环比均持平，连续第二个季度蝉联晶圆代工市场全球第三。报告称，中芯国际的季度业绩表现强劲，该公司为第三季度提供了强于预期的指引，这得益于中国需求持续复苏，包括 CIS、PMIC、物联网、TDDI 和 LDDIC 应用。中芯国际的 12 英寸需求正在改善，随着中国无晶圆厂客户的库存补充范围扩大，预计综合 ASP 将上涨。该公司对其年度收入增长持谨慎乐观态度，预计未来利用率将健康上升。

Counterpoint Research 分析师 Adam Chang 表示：“2024 年第二季度，全球代工行业表现出韧性，大部分增长主要由强劲的 AI 需求和智能手机库存补充推动。整

个半导体行业的需求复苏进展不均衡。虽然 AI 半导体等前沿应用正在经历强劲增长，但传统半导体的复苏速度较慢。由于早期的库存调整和当地无晶圆厂客户增加补货，中国代工厂的反弹速度更快。相比之下，非中国代工厂的复苏则更为缓慢。”（资料来源：集微网）

3) SEMI：预计 Q3 全球 IC 销售额同比增长 29%，中国增长最多

SEMI 在其与 TechInsights 联合编写的 2024 年第二季度半导体制造监测 (SMM) 报告中宣布，2024 年第二季度全球半导体制造业继续呈现改善迹象，IC 销售额大幅增长、资本支出趋于稳定，晶圆厂安装产能增加。尽管某些终端市场的复苏速度有所减缓，但 AI 芯片和高带宽内存 (HBM) 的强劲需求为行业增长提供了强劲的推动。

报告指出，季节性因素和弱于预期的消费需求影响了 2024 年上半年的电子产品销售，导致其同比下降 0.8%。从 2024 年第三季度开始，电子产品销售预计将出现反弹，同比增长 4%，环比 2024 年第二季度增长 9%。2024 年第二季度，IC 销售额同比增长 27%，预计 2024 年第三季度将进一步同比增长 29%，超过 2021 年的创纪录水平，因为人工智能推动的需求继续推动 IC 销售增长。需求改善还导致 2024 年上半年 IC 库存水平同比下降 2.6%。

2024 年第二季度，晶圆厂安装产能达到每季度 4050 万片晶圆（以 300 毫米晶圆当量计算），预计 2024 年第三季度将增长 1.6%。晶圆代工厂和逻辑相关产能在 2024 年第二季度增长 2.0%，预计在先进节点产能增加的推动下，2024 年第三季度将增长 1.9%。内存容量在 2024 年第二季度增长 0.7%，预计在 HBM 需求强劲和内存定价条件改善的推动下，2024 年第三季度将增长 1.1%。所有跟踪地区的安装产能在 2024 年第二季度均有所增加，尽管晶圆厂利用率一般，但中国仍是增长最快的地区。

2024 年上半年，半导体资本支出保持保守，同比下降 9.8%。随着对 AI 芯片需求的不断增长以及 HBM 的快速采用，预计从 2024 年第三季度开始，这一趋势将转为积极趋势，其中存储资本支出环比增长 16%，而非存储相关资本支出环比增长 6%。（资料来源：集微网）

4) Q2 全球晶圆代工营收环比增长 9%，中国大陆厂复苏速度快于同行

根据市调机构 Counterpoint Research 的《晶圆代工季度追踪》报告，2024 年第二季度全球晶圆代工行业收入环比增长约 9%，同比增长 23%。

Counterpoint 指出，代工营收环比增长主要得益于强劲的 AI 需求。CoWoS 供应仍然紧张，未来专注于 CoWoS-L 的产能扩张具有潜在上升空间。

另一方面，非人工智能需求复苏进展缓慢，预计 2024 年第三季度智能手机旺季表现不尽如人意，汽车和工业需求复苏也将延迟。

Counterpoint 称，值得注意的是，中国大陆的晶圆代工和半导体市场复苏速度

快于全球同行。中芯国际和华虹等中国大陆晶圆代工厂商公布了强劲的季度业绩和积极的指引，他们比全球成熟节点晶圆代工厂商更早触底，整体利用率已恢复至 80% 以上，因为中国大陆的无晶圆厂客户更早进入库存调整阶段。

受人工智能加速器需求持续强劲增长的推动，台积电 2024 年第二季度的季度营收略有超出预期。因此，台积电进一步将其年度营收预期从之前的 20% 中低段上调至 20% 中段。此外，台积电预计，到 2025 年底或 2026 年初，人工智能加速器的供需平衡将保持紧张。该公司还计划在 2025 年将其 CoWoS 产能至少再翻一番，以满足客户对人工智能的强劲需求。此外，Counterpoint 认为，2025 年 3nm 和 5/4nm 等先进节点的价格上涨可能性很高。

三星代工厂的收入环比增长，主要由于智能手机的库存预建和补货，在 2024 年第二季度以 13% 的市场份额保持第二的位置。该公司继续专注于为先进节点争取更多的移动和 AI/HPC 客户，并预计其年收入增长将超过行业增长。

中芯国际的季度业绩表现强劲，该公司为第三季度提供了强于预期的指引，这得益于中国大陆需求持续复苏，包括 CIS、PMIC、物联网、TDDI 和 LDDIC 应用。中芯国际的 12 英寸需求正在改善，随着中国大陆无晶圆厂客户的库存补充范围扩大，预计综合 ASP（平均销售价格）将上涨。该公司对其年度收入增长持谨慎乐观态度，预计未来利用率将健康上升。

Counterpoint 分析师 Adam Chang 表示：“2024 年第二季度，全球代工行业表现出韧性，大部分增长主要由强劲的 AI 需求和智能手机库存补充推动。整个半导体行业的需求复苏进展不均衡。虽然 AI 半导体等前沿应用正在经历强劲增长，但传统半导体的复苏速度较慢。由于早期的库存调整和当地无晶圆厂客户增加补货，中国大陆代工厂的反弹速度更快。相比之下，非中国大陆代工厂的复苏则更为缓慢。”（资料来源：集微网）

5) 台积电欧洲首座 12 英寸晶圆厂开建，获 50 亿欧元补贴

继在美国和日本投资晶圆厂之后，台积电 8 月 20 日正式为其德国德累斯顿晶圆厂举行奠基仪式，由魏哲家主持。该晶圆厂预计将于 2024 年底开始建设，最早于 2027 年第四季度开始量产。

台积电此次活动大咖云集，除了德国总理朔尔茨、欧盟委员会主席冯德莱恩外，台积电董事长魏哲家率领高层参与，包括共同运营长秦永沛、两位副共同运营长侯永清及张晓强出席现场奠基仪式。

欧盟委员会表示，已批准一项 50 亿欧元（55 亿美元）的德国国家援助措施，以支持欧洲半导体制造公司（ESMC）在德累斯顿建立新的晶圆厂。欧盟竞争事务主管维斯塔格在声明中说，这项德国的补贴“将强化欧洲的半导体产能，帮助我们实现绿色和数字转型，并为高技术就业带来工作机会”。

欧盟委员会主席冯德莱恩也指出，欧洲将迎来全球最大半导体公司台积电，她表示相当期待；持续重申打造强韧供应链、分散地缘政治风险。她强调，这是欧洲的机会，欧洲《芯片法案》为大势所趋。在台积电加入后，将努力实现 2030 年欧洲本地化生产芯片占全球 20% 市占率的目标。

德国总理朔尔茨表示：“我们依赖半导体来发展可持续的未来技术，但我们不能依赖世界其他地区的半导体供应。”朔尔茨已成为欧洲半导体行业最大的支持者，他寻求促进德国科技行业的发展并确保该国制造业关键零部件的供应。德国政府计划投入 200 亿欧元来支持国内芯片生产。其中包括为台积电工厂和为计划在马格德堡建设的英特尔公司工厂提供的 100 亿欧元援助。

台积电此前于 2023 年 8 月宣布，在德国与博世、英飞凌和恩智浦合作共同投资建立欧洲半导体制造公司（ESMC），其中台积电持股 70%，英飞凌、恩智浦、博世各持股 10%，总投资额预估逾 100 亿欧元（110.8 亿美元）。

台积电德累斯顿厂将是其欧洲首座 12 英寸晶圆厂，专注于汽车芯片，采用 28nm/22nm CMOS（互补金属氧化物半导体）和 16nm/12nm FinFET（鳍式场效应晶体管）技术，月产能约 4 万片晶圆，预计将创造 2000 个直接高科技就业机会。

半导体设备厂商表示，根据计划建设时间表，台积电德国首座晶圆厂将于 2024 年第四季动工，预计 2026 年第三季设备进厂，2027 年第一季建成月产能 3000 片晶圆的微型产线，最早于 2027 年第四季开始量产，2028 年逐步达成月产能 4 万片晶圆的目标。（资料来源：集微网）

6) 前 7 个月中国芯片制造设备进口额达 1855 亿元

根据中国海关总署本周发布的最新贸易数据，今年 1~7 月中国企业进口了价值近 260 亿美元（约合 1855 亿元人民币）的芯片制造设备，这一数字超过了 2021 年同期创下的最高纪录（238 亿美元）。

过去一年，中国从 Tokyo Electron（TEL）、ASML 和应用材料等公司的采购量大幅增长。这种消费热潮推动荷兰对华出口创下新高，7 月份出口额超过 20 亿美元，这是有史以来第二次超过 20 亿美元。

荷兰公司 ASML 第二季度对华销售额飙升 21%，达到其总收入的近一半，销售额由不受限制的旧系统组成。

进口继续保持高位

即使在美国及其盟友禁止中国企业采购最先进的设备后，中国企业仍在迅速扩大采购规模。

国际半导体产业协会（SEMI）6 月份估计，继今年中国芯片制造商的晶圆产量增幅达到 15% 之后，预计到 2025 年，其晶圆产量将增长 14%，达到每月 1010 万片，占

全球芯片产量的近三分之一。

美国一直在收紧限制中国在半导体和人工智能等关键技术领域发展的规定。这些措施包括多次实施出口管制，限制先进芯片和制造这些部件的设备销售。(资料来源：集微网)

7) 三星：最新 2 纳米制程可将芯片尺寸缩 17%

三星电子晶圆代工高层透露，最新 2 纳米制程技术可将芯片尺寸缩小 17%。

三星晶圆代工制程设计套件 (PDK) 研发团队副总裁 Lee Sungjae 在《Siemens EDA Forum 2024》的主题演说中指出，三星采用的最新“背面电轨”芯片制造技术，可让 2 纳米芯片的尺寸比传统前端 (front-end) 配电网络 (PDN) 技术缩小 17%。

Sungjae 指出，三星预定 2027 年量产 2 纳米芯片时采用 BSPDN 技术，该科技还可将效能、功率分别提升 8%、15%。这是三星晶圆代工事业首度有高层向大众揭露 BSPDN 细节。

BSPDN 被称为次世代晶圆代工技术，主要是将电轨置于硅晶圆背面，进而排除电与讯号线的瓶颈，进而缩小芯片尺寸。

相较之下，英特尔预计今年就会在相当于 2 纳米的 Intel 20A 制程采用 BSPDN 技术，该公司将之称为“PowerVia”。台积电则计划于 2026 年底左右，对 1.6 纳米以下制程导入 BSPDN 技术。

另一方面，Lee 还公布次世代 GAA 制程的产品路线图及芯片效能。三星计划今年下半量产基于第二代“环绕式闸极” (gate-all-around, GAA) 制程技术 (SF3) 的 3 纳米芯片，接下来的 2 纳米也会采用 GAA 制程。Lee 指出，跟第一代 GAA 制程相比，SF3 可分别将芯片效能、功率提升 30%、50%，芯片尺寸缩小 35%。(资料来源：集微网)

8) 传三星今年投产首批 HBM4 设备，2025 年提供样品

三星今年稍晚推首款 HBM4 存储芯片元件，2025 年初出货。三星将采最新 10 纳米级制造 HBM4 DRAM，4 纳米级逻辑制造 HBM4 基础芯片。

三星制造第一批 HBM4 元件和基础芯片后，存储芯片和逻辑晶圆厂需几个月生产组装，三星再内测 HBM4 堆叠，并提供主客户样品，推测应是 AI 和 HPC 处理器领先厂商。三星拒绝回应，外界预测 2025 年底开始量产 HBM4，不过实际产品何时出现仍有待观察。

三星采最新 10 纳米级 DRAM 制程制造 HBM4 存储芯片层级，并 4 纳米级逻辑制造 2048 位元介面 HBM4 基础芯片，可直接安装于三星自家 SAINT -D 或类似技术处理器。

标准组织 JEDEC 固态技术协会公布，HBM4 将指定 24 Gb 和 32 Gb 容量密度，可选择支援 4 层、8 层、12 层和 16 层 TSV 堆栈。已就高达 6.4Gbps 速度达成初步协议，并讨论更高频率。目前很难预测三星初期 HBM4 模组配置，不过据称三星明年下半年量产 12 层 HBM4 堆叠。

与此同时，竞争对手 SK 海力士下半年将量产 HBM4，但没透露出样时间。SK 海力士最初倾向使用 1b DRAM 技术制造 HBM4 存储芯片层级，三星则决定采用 1c 生产。

SK 海力士将与台积电合作，打造 HBM4 基础芯片。台积电在 2024 年欧洲技术研讨会上透露，计划采用先进 12FFC+（12 纳米级）和 N5（5 纳米级）制程技术生产基础芯片。透过台积电技术，除了逻辑整合上更密集、互连间距更细致，存储芯片可直接放置在 CPU 和 GPU。以台积电的 12FFC+制造的基础芯片，可使用硅中介层连接存储芯片与主机处理器。（资料来源：集微网）

2.2 消费电子板块

1) 机构：Q2 全球智能手机出货 2.89 亿部，三星份额 19%居首

8 月 22 日公布的数据显示，韩国科技巨头三星电子凭借 Galaxy S24 系列，在 2024 年第二季度保持了全球智能手机市场（按出货量计算）的领先地位。

根据 Counterpoint Research 的数据，今年第二季度全球智能手机出货量达到 2.891 亿部，比 2023 年同期增长 8%。按制造商划分，三星以 19%的市场份额占据榜首，保持了第一季度的领先地位。苹果公司以 16%的份额位居第二，小米（15%）、OPPO 和 vivo（各占 9%）位列前五。

该市场研究公司指出：“亚洲和北美等主要地区的复苏推动了智能手机出货量的强劲增长。”而“三星的增长主要得益于 Galaxy A 和 Galaxy S24 系列。”

在韩国智能手机市场，按销量计算，2024 年第二季度三星与苹果之间的市场份额差距进一步扩大。三星第二季度在韩国的市场份额为 76%，较上一季度的 75%上升 1 个百分点，这归功于中低端机型的推出。另一方面，苹果的 iPhone 在 2024 年第二季度的市场份额为 22%，比上一季度下降了 2 个百分点。两家公司的差距从 2024 年第一季度的 51 个百分点扩大到第二季度的 54 个百分点。

三星计划在 2024 年将 Galaxy AI 应用于超过 2 亿台 Galaxy 产品。为了保持其市场份额，它还将推出准高端机型 Galaxy S24 FE 和量子安全智能手机 Galaxy Quantum 5 等新产品。（资料来源：集微网）

2) 三星将于 10 月推出超薄折叠机 Fold Slim，厚度 10~11mm

三星电子计划最早于 10 月推出一款折叠手机的超薄机型，铰链厚度将降至 10 毫

米左右，这标志着其在竞争激烈的折叠手机市场上迈出了重要一步。这款新机型被称为“Fold Slim”，将7月发布的Galaxy Z Fold 6的厚度降至10~11mm左右。

自2019年Galaxy Fold首次发布以来，三星电子已在折叠屏手机市场占据主导地位数年。然而，OPPO、小米等中国公司正在迅速追赶三星，并提升折叠屏手机技术。

近年来，虽然人工智能（AI）已成为智能手机市场软件方面的主要差异化因素，但硬件方面则趋向于超轻、超薄设计。折叠式手机的重量和厚度被认为是其普及的弱点，厂商的目标是将这些方面提升到传统直板式智能手机的水平。

推出更轻薄的机型似乎是为了应对中国公司在可折叠手机市场日益占据主导地位而采取的增强硬件竞争力的策略。荣耀将于下个月在德国IFA 2024上发布“荣耀Magic V3”，厚度为9.2mm。在可折叠手机的广告中，荣耀按年份列出了三星的Fold系列，强调三星Fold 6折叠时的厚度为12.1mm，而他们的产品厚度则为9.2mm。

随着中国显示器企业在柔性OLED技术和铰链技术上的进步，三星电子在折叠屏手机市场的份额被明显蚕食。截至第一季度，中国企业以35%的市场份额位居第一，三星电子以23%的份额紧随其后。当然，中国企业的产品主要还是在国内市场消费。

在三星电子专注于人工智能的同时，中国企业也在迅速推出更薄的折叠屏机型。不仅荣耀，小米的Mix Fold 4(9.5mm)和谷歌最近发布的Pixel 9 Pro Fold(10.5mm)都以比三星机型更薄而脱颖而出。

三星电子的轻薄设计并非一次性努力，而是将应用于各种外形。三星电子正考虑在明年初发布的Galaxy S25系列中增加轻薄机型。苹果也有望在明年的iPhone 17系列中推出轻薄机型。（资料来源：集微网）

3) 机构：2024年全球笔电出货量将增长3.7%，供应链转移比例增至12.4%

根据TrendForce（集邦咨询）最新研究，预估2024年全球笔记本电脑（笔电）出货量将达约1.74亿台，较2023年增长3.7%。

集邦咨询指出，换机需求主要集中在入门级消费市场和教育市场。AI笔电方面，厂商虽然在2024年下半年陆续推出，但高昂的售价可能会推迟消费者的采购，因此预计2025年才能看到AI机种对供应链带来的实质贡献，届时，在商务换机需求推动下，全球笔电出货量预期将年增5%。

从供应链来看，集邦咨询表示，全球供应链格局近年发生显著变化，笔电品牌商逐步将生产链布局转移到越南和泰国。

集邦咨询表示，在戴尔和苹果的积极布局下，2024年越南笔记型电脑代工比重预计将提升至6%。泰国虽为后起之秀，但随着惠普与广达在当地的密切合作，加上英业达将于下半年加入生产行列，预计泰国的全球笔电生产占比将快速攀升至2.3%。

集邦咨询预计，2024年全球笔电供应链转移比例提升至12.4%。全球笔电生产正

朝著更加多元化和灵活化的方向发展。（资料来源：集微网）

4) 研调：AR 装置 2030 年出货量估 2550 万台

研调机构集邦科技最新调查，受扩增实境（AR）装置品牌厂的产品规划带动，加上人工智能（AI）技术、应用生态系统发展助力，预估 2030 年 AR 装置出货规模可达 2550 万台。

集邦指出，扩增实境在 2023 至 2030 年的年复合成长率为 67%。其中，LEDoS（LED on Silicon）光源在此领域的渗透率将逐渐提高，预估 2024 年 LEDoS 在扩增实境装置的市占率为 18%，2030 年将达到 44%，成为市场主流技术。

集邦表示，AR 装置热度逐年攀升，除苹果（Apple）、Meta 等国际品牌未来有相关产品计划，中国厂商在 LEDoS 领域的投入也较为活跃。扩增实境设备对光机模组体积、高环境光下的穿透效果，显示系统的亮度都有严格要求。

另外，AR 装置的显示架构包含光学引擎、光学系统两个核心系统。其中，光学引擎决定刷新率、色彩与亮度上限，光学系统则控制成像特性；两个系统共同影响可视角度、光学效率等设备关键性能指标。（资料来源：集微网）

5) 14/16 英寸 MacBook Pro 的屏幕面板已于 7 月和 8 月开始出货

虽然还无法确定 M4MacBook Pro 的更新时间，但供应链的显示屏出货量可能预示着 M4 MacBook Pro 即将在秋季发布。传言认为，苹果公司将在今年秋季为其 Mac 产品线带来一系列 M4 处理器更新。虽然不能保证所有猜测的机型都能获得芯片升级，但似乎有一个产品系列很有可能出现。

根据 Display Supply Chain Consultants 首席执行官罗斯-杨（Ross Young）周四在 X 上发表的一篇现已删除的文章，14 英寸 MacBook Pro 和 16 英寸 MacBook Pro 的面板出货已于 7 月和 8 月开始。

Young 补充说，根据这些出货量，在第四季度推出配备 M4 的机型"是合理的"。考虑到 MacBook Pro 更新换代需要长达数月的部件准备时间，这是一个相当不错的假设。

这位分析师的评论也给其他 Mac 机型带来了秋季更新的希望，可能会在 9 月或 10 月的发布会上发布。目前最有可能在秋季更新的产品包括外形更小巧的 Mac mini 和新款 iMac。MacBook Air、Mac Studio 和 Mac Pro 等产品预计将于 2025 年更新。（资料来源：集微网）

2.3 汽车电子板块

1) 第二季全球新能源车销量 376.9 万辆，季增近 30%，年增 24.2%

研调机构 TrendForce 最新研究，第二季全球新能源车(含纯电动车、插电混合式电动车、氢燃料电池车)销量为 376.9 万辆，季增近 30%，年增 24.2%；其中，特斯拉维持纯电车市占率第一，但销量较去年下降，比亚迪除纯电车销量稳健，插电混合式电动车第二季的市占率也突破 36%。

TrendForce 表示，第二季全球纯电动车(BEV)销量为 232.8 万辆，年增 8%。市占第一的特斯拉销量年减 4.7%，在中国和美国等两大市场皆祭出降价、优惠利率等措施。

比亚迪(不含腾势)位居全球第二，BEV 销量较去年同期成长约 20%。此外，比亚迪外销表现强韧，第二季出口超过 10 万辆含纯电车在内的新能源车。

纯电车销售第三至五名依序为 Volkswagen、上汽通用五菱和 BMW，彼此的市占率差异不大。蔚来汽车本季销量较去年同期成长 144%，一举回到第 7 名的位置。吉利控股集团旗下的极氪品牌排在第 9 名，销量主要来自极氪 001，受到改款和中国新能源车下乡计划等政策影响，极氪 001 第二季的销量大幅提高。

TrendForce 统计，2024 年第二季全球插电混合式电动车(PHEV)销售 143.9 万辆，年成长 64.2%，销量前四名皆为中国品牌。比亚迪品牌市占率提升到 36.1%，与第二名的理想汽车拉开明显差距，第三、四名由傲图(AITO)和长安汽车拿下。Volvo Cars 和 Mercedes-Benz 分居五、六名。

BMW 第二季 PHEV 销量则与去年同期持平，排名第八。第十名的 Jeep 虽然销量、排名皆下滑，仍是美国最畅销的 PHEV 品牌，目前美国仅有七款 PHEV 车取得联邦政府补助，其中两款就由 Jeep 生产。(资料来源：集微网)

2.4 面板板块

1) 研调：8 月电视面板续跌，压力持续扩大

研调机构集邦科技研究副总经理范博毓表示，电视品牌为争取更多面板跌价空间，下单趋于保守，对第 4 季促销需求期待不高，库存控管也更加严谨，电视面板价格下跌压力正持续扩大中。

集邦调查，8 月小尺寸电视面板仍有新兴市场等需求支撑，32 英寸下跌 1 美元，43 英寸持平。至于中大尺寸面板跌价幅度明显扩大，50 英寸下跌 3~4 美元，55 英寸下跌 2~3 美元，65 英寸与 75 英寸则下跌 3~4 美元。

范博毓指出，由于时序越近年底，需求将越来越朝向淡季的节奏调整，因此就算面板厂持续运行按需生产调控策略，短时间之内也不容易见到面板价格止稳，目前仍

需观察主要面板厂在 10 月假期计划停产两周的想法是否能确切运行，借此机会来寻求面板价格走稳的契机。

液晶显示器 (Monitor) 面板进入 8 月后，整体需求逐步减弱，部分客户的拉货动能下滑，也影响面板价格。以面板厂来看，目前仍多是希望面板价格能持续维持台面上的稳定，转以台面下折让或其他方式给客户实质的优惠。

不过以客户端来看，在需求减弱下，部分客户可能还是希望能够实际反映在面板价格的下跌上，实际结果仍需视买卖双方议价状况而定。目前预期 8 月的液晶显示器面板价格仍将全面持平。

笔电面板方面，进入 8 月后，买卖双方在价格想法上都不如第 2 季积极，在经过第 2 季的面板出货大幅增长后，面板厂仍在观察下半年品牌客户采购动能变化，在全年采购量能已大致抵定下，面板厂争夺市占率等策略操作空间实际上已逐渐缩小。

同时品牌客户在第 3 季也暂无大幅下修面板采购量的想法，在供需双方操作都趋向持稳状态下，预期 8 月笔电面板价格仍将持平。（资料来源：集微网）

三、 公司动态跟踪

图表 9：过去一周股东增减持更新

证券代码	证券简称	公告日期	方向	股东名称	股东身份	拟变动数量上限	拟变动数量 上限占总股本比 (%)
300916.SZ	朗特智能	2024-08-23	减持	苟兴荣	股东兼公司监事	1,446,440.00	1.00
002922.SZ	伊戈尔	2024-08-22	减持	王一龙	董事	2,181,900.00	0.56
000636.SZ	风华高科	2024-08-20	增持	广东省广晟控股集团有限公司	公司第一大股东		
688259.SH	创耀科技	2024-08-24	减持	中新苏州工业园区创业投资有限公司	5%以上非第一大股东	2,234,000.00	2.00
300184.SZ	力源信息	2024-08-24	减持	王晓东	董事兼高级管理人员	618,300.00	0.05
300184.SZ	力源信息	2024-08-24	减持	刘昌柏	高级管理人员	99,988.00	0.01
300184.SZ	力源信息	2024-08-24	减持	高惠谊	控股股东的一致行动人	11,540,119.00	1.00
600666.SH	奥瑞德	2024-08-22	增持	刘鑫	项目经理		
600666.SH	奥瑞德	2024-08-22	增持	陈盛	财务部经理		
600666.SH	奥瑞德	2024-08-22	增持	陈俊标	产品经理		
600666.SH	奥瑞德	2024-08-22	增持	覃思维	项目经理		
600666.SH	奥瑞德	2024-08-22	增持	王彬彬	投融资总监		
600666.SH	奥瑞德	2024-08-22	增持	易雅君	子公司总经理		
600666.SH	奥瑞德	2024-08-22	增持	尹瀚禹	子公司副总经理		
600666.SH	奥瑞德	2024-08-22	增持	叶楠	内审部经理		
600666.SH	奥瑞德	2024-08-22	增持	刘静雯	法务总监		
600666.SH	奥瑞德	2024-08-22	增持	江洋	董事长, 总经理		
600666.SH	奥瑞德	2024-08-22	增持	朱三高	董事, 财务总监		

300684.SZ	中石科技	2024-08-21	减持	吴晓宁, 叶露, HAN WU(吴憾)	控股股东, 实际控制人及其一致行动人	2,982,483.00	1.00
603633.SH	徕木股份	2024-08-22	增持	方培喜	股东, 董事, 副总经理		
831526.BJ	凯华材料	2024-08-21	减持	张光明	董事	79,866.00	0.10
831526.BJ	凯华材料	2024-08-21	减持	郝帅	高级管理人员	4,250.00	0.01
831526.BJ	凯华材料	2024-08-21	减持	周庆丰	董事	121,666.00	0.15
831526.BJ	凯华材料	2024-08-21	减持	郝艳艳	高级管理人员	49,166.00	0.06
301359.SZ	东南电子	2024-08-22	增持	仇文奎	控股股东, 实际控制人之一, 董事长, 总经理		
688766.SH	普冉股份	2024-08-24	减持	嘉兴得月投资合伙企业(有限合伙)	5%以下股东	51,295.00	0.07
688766.SH	普冉股份	2024-08-24	减持	杭州早月投资合伙企业(有限合伙)	5%以下股东	892,674.00	1.18
688766.SH	普冉股份	2024-08-24	减持	杭州晓月投资合伙企业(有限合伙)	5%以下股东	578,396.00	0.77
002463.SZ	沪电股份	2024-08-23	减持	李明贵	高级管理人员	139,800.00	0.01
002981.SZ	朝阳科技	2024-08-20	减持	宁波鹏辰创业投资合伙企业(有限合伙)	股东	2,880,000.00	3.00
688548.SH	广钢气体	2024-08-24	减持	井冈山橙兴气华股权投资合伙企业(有限合伙)	5%以下股东	26,387,970.00	2.00

数据来源: Wind, 华福证券研究所

图表 10: 过去一周股权激励一览

代码	名称	公告日期	方案进度	激励方式	激励总数(万)	激励总数占当时总股本比例(%)	期权初始行权价格
002463.SZ	沪电股份	2024-08-23	董事会预案	上市公司定向发行股票	3,000.00	1.5665	20.22
300136.SZ	信维通信	2024-08-22	董事会预案	上市公司定向发行股票及上市公司提取激励基金买入流通股	410.00	0.4237	9.15

数据来源: Wind, 华福证券研究所

四、 风险提示

技术发展及落地不及预期; 下游终端出货不及预期; 下游需求不及预期; 市场竞争加剧风险; 地缘政治风险; 行业景气不及预期。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

一般声明

华福证券有限责任公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料，该等公开资料的准确性及完整性由其发布者负责，本公司及其研究人员对该等信息不作任何保证。本报告中的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，之后可能会随情况的变化而调整。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

在任何情况下，本报告所载的信息或所做出的任何建议、意见及推测并不构成所述证券买卖的出价或询价，也不构成对所述金融产品、产品发行或管理人作出任何形式的保证。在任何情况下，本公司仅承诺以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告以供投资者参考，但不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的承诺或担保。投资者应自行决策，自担投资风险。

本报告版权归“华福证券有限责任公司”所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

特别声明

投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有本报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

投资评级声明

类别	评级	评级说明
公司评级	买入	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅在 20%以上
	持有	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅介于 10%与 20%之间
	中性	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅介于-10%与 10%之间
	回避	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅介于-20%与-10%之间
	卖出	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅在-20%以下
行业评级	强于大市	未来 6 个月内，行业整体回报高于市场基准指数 5%以上
	跟随大市	未来 6 个月内，行业整体回报介于市场基准指数-5%与 5%之间
	弱于大市	未来 6 个月内，行业整体回报低于市场基准指数-5%以下

备注：评级标准为报告发布日后的 6~12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。其中，A 股市场以沪深 300 指数为基准；香港市场以恒生指数为基准；美股市场以标普 500 指数或纳斯达克综合指数为基准（另有说明的除外）。

联系方式

华福证券研究所 上海

公司地址：上海市浦东新区浦明路 1436 号陆家嘴滨江中心 MT 座 20 层

邮编：200120

邮箱：hfyjs@hfzq.com.cn